

專利名稱：雙層電路板連接器結構

應用領域：DNT - CDFP

專利號：TWM669881

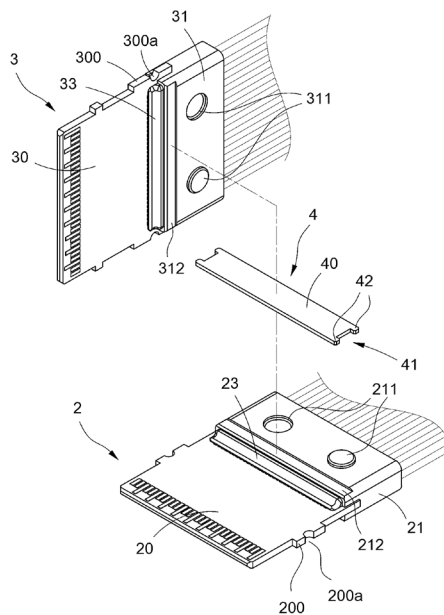
申請日期：2024-12-19

公告日：2025-05-01

申請地區：TW, CN, US

發明人：鄭杰明

主要圖示



專利說明

屏蔽構件(4)位於兩個電路板之間，能夠遮蔽第一電路模組(2)與第二電路模組(3)各自的焊接處，可達到降低第一電路板(20)與第二電路板(30)之間所造成的串擾問題，且此種設計之連接器採用上下疊置(組裝方向F2)的組裝方式，且插接方向(F1)與組裝方向(F2)垂直，因此連接器能夠承受較大的插拔力，具有良好的組裝結構，不易因插拔而損壞。